



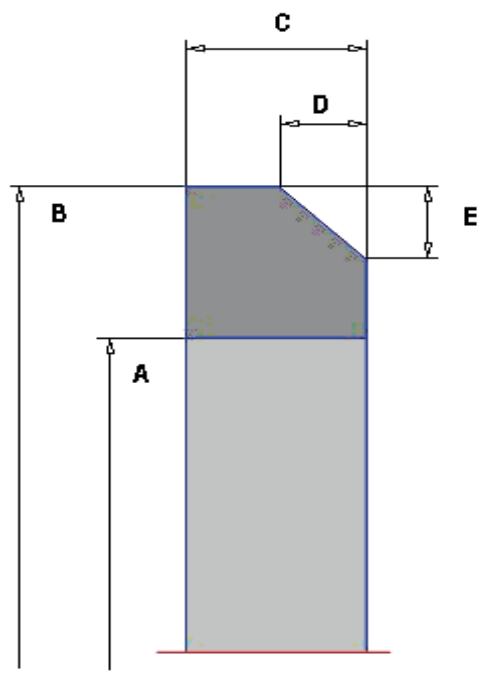
Materiales para fabricar

PERFIL

DST110

1 COMPONENTE
RESPALDO

MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
PUR	-20 °C A 115 °C	-
NBR	-30 °C A 110 °C	-
FKM	-20 °C A 210 °C	-
EPDM	-45 °C A 130 °C	-
TBR	-200 °C A 260 °C	-
TFV	-200 °C A 260 °C	-
HNBR	-30 °C A 150 °C	-
PUA	-20 °C A 110 °C	-
PUG	-30 °C A 110 °C	-
POM	-45 °C A 100 °C	-
PA	-40 °C A 110 °C	-
NYL	-45 °C A 100 °C	-



A:

Interior sello

B:

Exterior sello

C:

Altura sello

D:

Ancho de chaflan

E:

Altura de chaflan

Material requerido:

Cantidad Solicitada:

Observaciones: